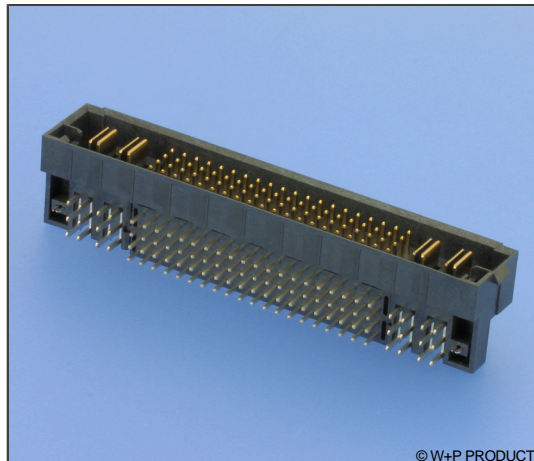


Power-Signal-Terminal RM 5,00/2,00mm, Stiftkontakte, gewinkelt Power-Terminal 5.00mm Pitch, Male, Right-angled

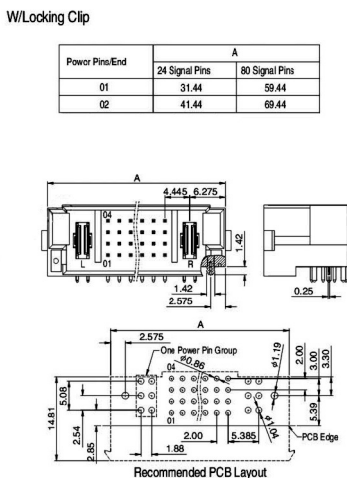
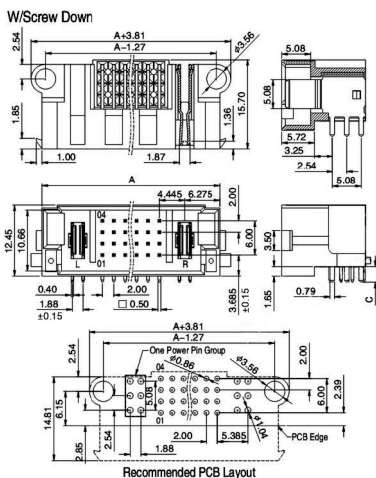
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	Power: 600 V AC / 848 V DC Signal: 300 V AC / 424 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	Power: 600 V AC / 848 V DC Signal: 300 V AC / 424 V DC
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	Power: 24,7 A / Signal: 1 A Power: 24.7 A / Signal: 1 A
Verarbeitung <i>Processing</i>	-55 °C ... +105 °C -55° ... +105 °C 260 °C für 10s 260 °C for 10s



© W+P PRODUCTS

Gegenstecker / Mating Connectors :
454 (24/80), 456 (24/80)



Series	Power Left*	Signal*	Power Right*	Terminals*	Plating (Power)*	Plating (Signal)*	Board Locks*	Packaging*
457	01	80	01	21	00	00	20	ST
	01/02 Contacts	24/80 Contacts	01/02 Contacts	20 C=2.72mm 21 C=3.52mm 22 C=4.32mm	00 Au flash 50 Sn 60 Sel. Au/Sn 610 Sel. Au 10µ"/Sn	00 Au flash 50 Sn 60 Sel. Au/Sn 610 Sel. Au 10µ"/Sn	20 Locking Clips 30 Screw down	ST TRAY

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:
ST In Stangen / In tubes
TRAY Auf Tray / On tray

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

